

ICS 31.200  
L 55



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15878—1995

---

## 小外形封装引线框架规范

Specification of leadframes for small outline package

1995-12-22 发布

1996-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 小外形封装引线框架规范

GB/T 15878—1995

Specification of leadframes for small outline package

---

### 1 主题内容与适用范围

#### 1.1 主题内容

本规范规定了半导体集成电路小外形封装(SOP)引线框架(以下简称引线框架)的技术要求及检验规则。

#### 1.2 适用范围

本规范适用于半导体集成电路塑料小外形封装冲制型引线框架。

### 2 引用标准

GB 7092—93 半导体集成电路外形尺寸

GB/T 14112—93 半导体集成电路塑料双列封装冲制型引线框架规范

GB/T 14113—93 半导体集成电路封装术语

SJ/Z 9007—87 计数检查抽样方案和程序

### 3 术语、符号、代号

本规范所用术语、符号和代号应按 GB/T 14113 的规定。

### 4 技术要求

#### 4.1 设计

引线框架的外形尺寸应符合 GB 7092 的有关规定,并符合引线框架设计的要求。

##### 4.1.1 精压区

最小扁平引线键合区,宽度为标称引线宽度的 80%,长度为 0.381mm。

##### 4.1.2 精压深度

4.1.2.1 对于 0.2mm 厚的材料,精压深度最小为 0.013mm,最大为 0.051mm。

4.1.2.2 对于 0.25mm 厚的材料,精压深度最小为 0.013mm,最大为 0.051mm。

4.1.2.3 最大精压深度也可能受最小引线间距要求的限制,最小精压深度也可能受最小键合区要求的限制。

##### 4.1.3 金属间的间隔

引线框架各内引线之间,内引线与芯片粘接区之间的距离不小于 0.152mm。

#### 4.2 引线框架形状和位置公差

##### 4.2.1 引线扭曲

引线框架内引线扭曲不得超过  $3^{\circ}30'$ ,即每 0.254mm 引线宽度范围最大偏离不超过 0.015mm。

##### 4.2.2 芯片粘接区斜度和平整度

---

国家技术监督局 1995-12-22 批准

1996-08-01 实施